19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公告

許公 報(B2)

昭61 - 31587

@Int_Cl.4

識別記号

厅内整理番号

❷❸公告 昭和61年(1986)7月21日

H 01 J 31/12

B - 6722 - 5C

発明の数 1 (全4頁)

劉発明の名称 画像表示装置

> ②特 願 昭52-114295

69公 開 昭54-47472

御出 願 昭52(1977)9月21日 ❸昭54(1979)4月14日

辺 正 則 ⑫発 明 者 渡 70発 明 者 野々村

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

欽 造 松下電器産業株式会社 の出 願 人

門真市大字門真1006番地

20代 理 人 弁理士 中尾

敏男 外1名

栄 二 審査官 島野

1

砂特許請求の範囲

1 実質的に平面な電子源と、前記電子源から電 子ビームを取り出す手段と、取り出された電子ビ ームの選択的通過を制御する制御手段と、電子ビ る加速手段と、電子ビームの衝突によつて発光す る発光体とも具備し、前記集束手段を電子ビーム 入射側が広い錐体状の貫通孔を有する電極板にて 構成してなる画像表示装置。

- てなる特許請求の範囲第1項に記載の画像表示装 置。
- 3 集束手段を構成する電極板の表面が二次電子 放出係数が1より大きい二次電子放出材料で被覆 項または第2項に記載の画像表示装置。
- 4 二次電子放出材料や、銀ーマグネシウム合 金、ベリリウムーマグネシウム合金、銅ーベリリ ウム合金の群から選ばれる一種の合金であること 表示装置。
- 5 二次電子放出材料がアルミニウムと酸化アル ミニウムの複合材料であることを特徴とする特許 請求の範囲第3項に記載の画像表示装置。
- 化物であることを特徴とする特許請求の範囲第3 項に記載の画像表示装置。
- 7 二次電子放出材料がアルカリ土類金属の酸化

物またはハロゲン化物であることを特徴とする特 許請求の範囲第3項に記載の画像表示装置。

2

8 二次電子放出材料が銀ー酸化セシウムーセシ ウム、銀一酸化ルビジウム、セシウムーアンチモ ームを集束する集束手段と、電子ビームを加速す 5 ンから選ばれる一種の材料であることを特徴とす る特許請求の範囲第3項に記載の画像表示装置。 発明の詳細な説明

本発明は平面状電子源から取り出された電子ビ ームを発光体に衡突させて画像表示を行う平板状 2 制御手段と集束手段との間に偏向手段を設け 10 の画像表示装置に関し、特に集中電極極を通過す る電子ビーム電流を増加して高輝度の画像が得ら れる画像表示装置を提供しようとするものであ

従来、平板状電子源から放出される電子ビーム されていることを特徴とする特許請求の範囲第1 15 を一対のマトリツクス型電子ビーム制御電極によ つて制御し、文字または画像を表示する平板状表 示装置を構成する試みがなされている。第1図に この種の表示装置の要部構成図の一例を示す。こ の第1図において、1は平板状電子源であって熱 を特徴とする特許請求の範囲第3項に記載の画像 20 陰極、電界放出冷陰極などが使用される。2は多 数の貫通孔6を穿設した格子状電極板で、陰極1 に対して正の電圧が印加され、電子ビームを取り 出す。電子ピームの一部は格子状電極板2の貫通 孔6を通過し、電子ビーム制御電極板3の表示に 6 二次電子放出材料がアルカリ金属のハロゲン 25 達する。制御電極板 3 および 4 には多数の貫通孔 6 a および 6 bが縦横に規則正しく穿設されてお り、各行、列毎に短冊材電極7および8が設けら れていて、お互に直交するように適当な間隔を保

つて、かつ直交する各交点において両制御電極板 3, 4に設けられた貫通孔6a, 6bが一致する ように配置されている。電子ビーム制御電極板3 の表面に達した電子ビームは各短冊状電極極7に 印加される信号電圧に対応して変調され、貫通孔 5 示す。制御電極板4の貫通孔6 bを通過した電子 6 a を通過し、電子ビーム制御電極板 4 の表面に 達する。電子ビームは制御電極板4においても前 記制御電極板 3 と同様なメカニズムによつて変調 され貫通孔6bを通過する。貫通孔6bを通過し た電子ビームは加速電極板9に印加された正の高 10 電子放出係数に応じて2次電子14 e が放出さ 電圧によつて加速され、加速電極板9の表面に塗 着された螢光体膜10に衝突して発光せしめる。 なお11はガラス板である。以上が従来の画像表 示装置の概略であるが、一般に電子ビーム制御電 極板4と加速電極板9の間に、電子ビームを集束 15 集束され、螢光体10に入射する電子ビームに寄 またはコリメートし、かつ、加速電極板9に印加 される高電圧によつて短冊状電極8の電位が影響 を受けないように電極板が挿入される。

このように構成した表示装置において、電子ビ に信号電圧を順次印加すると文字または画像を表 示することができる。

このような画族表示装置の輝度は各画素に対応 する制御電極板3, 4の貫通孔6a, 6bを通過 する電子ビーム電流および電子ビームのエネルギ 25 の便宜上、集束電極 1 2 の貫通孔 1 3 を誇張して によつて決まる。然るに制御電極板3,4の貫通 孔6a,6bの有効面積比(全貫通孔の面積を表 示面積で除した値)は一般に20~25%であつて、 陰極から放出された電子の20~25%しか有効に利 用できない。特に、解像度のよい画像を得るため 30 ツチのものである。また、その孔径についてては に、制御電極に設けられる貫通孔の密度を大きく すると更に、有効面積比は小さくなり、明るい画 像を得ることができない欠点がある。

本発明は制御手段によつて制御された電子ビー 子ピーム集束電極の形状を特定し、集束電極の表 面の材質を二次電子放出係数の大きな材料で被覆 することによつて、電子ビーム電流を増倍し、所 期の目的を達成しようとするものである。以下に 本発明の実施例について説明する。

第2図は本発明の一実施例を示す画像表示装置 の斜視図である。この第2図において、第1図と 同一構成物に対して同一番号が付してある。12 は制御電極板4と加速電極板9との間に配設され

た集束電極であり、制御電極板4の貫通孔6 bに 対応して規則正しく、電子ピーム入射側が広い錘 体状、例えば円錘台状の貫通孔13が設けられて いる。この集束電極12の水平断面図を第3図に ビーム14の一部は集束電極12に衝突すること なく貫通孔13を通過し、加速電極板9によつて 加速される。また、電子ビーム14の他の一部は 集束電極12に衝突し、集束電極12表面の2次 れ、加速電極板9によつて加速される。 なお、放 出される2次電子14 eは、当初拡散する方向に 放出されても、集束電極12と加速電極9との間 の電界により強力により強力に引かれて、すぐに 与する。この2次電子14eの放出量は集束電極 12表面の材料等によつて異なるとともに電子ビ ーム14の入射角によつて変化する。一般に、電 子ピームの入射角を 0 とすると、2 次電子放出量 - ム制御電極板3および4の各短冊状電極7,8 20 は $\cos heta$ の逆数に比例することが知られている。 従つて、集束電極12の貫通孔13の形状が円錘 台状であるので電子ビーム14の入射角が大きく なり、実質的に2次電子放出係数が2~3倍大き くなる。なお、第2図及び第3図においては説明 示したが、実際には従来技術の説明において記載 した集束用の電極と同様の寸法である。すなわ ち、従来のいわゆるメツシュ状電極のように、制 御電極板4の貫通孔6bよりもはるかに小さいピ 特に限定されるものではなく、仕様に応じて適当 に設定することができる。

また、さらに集束電極12表面を5次電子放出係 数の大きい材料で被覆することによつて更に集束 ムを、制御手段と加速手段の中間に設けられる電 35 電極 1 2 を通過する電子ビーム電流が大きくな

2次電子放出係数の大きい材料を表に示す。

麦

			
被覆材料	2次電子 放出係数	被覆材料	2次電子 放出係数
ガラス		アルカリ 土類化合 物	
パイレツ クス	2,3	CaF₂	3.2
ソーダ	2.1	BaF ₂	4.5
石 英	2.1~2.9	BeO	3.4
グラウン ド	3.1	MgO	2.4
ハロゲン化 アルカリ		Ca0	2.2
LiF	5.6	BaO	2.3
NaF	5.7	絶縁物	
NaC1	6.8	Al ₂ O ₃	1.5~4.8
KC1	7.5	マイカ	2.4
RbC1	5.8		
NaBr	6.2		
Na I	5.5		·

上表以外の被覆材料としてはAg-Ag合金、Be -Mg合金、Cu-Be合金等がある。これらの合金 は適当な温度と雰囲気において熱処理されると入 数が4~10と大きく、好ましい。なお、Cu-Be 合金は2次電子放出係数がやや小さいが2次電子 放放出面が極めて安定である。またAg-Cs-O, Ag-RbO-Rb, Cs-Sbなどアルカリ金属に な点もあるが2次電子放出係数が特に大きい。さ らにBe, Mg, Ca, Baなどのアルカリ土類金属は 表面を単分子層程度酸化されると、金属表面より 2~3倍程度2次放出係数が大きくなる。また Alの表面に酸化層を設けたものも安定で、かつ 35 きくなり、従つて解像度が向上する。すなわち、 2次電子放出係数が大きい。実験結果によれば集 東電極 1 2 にAlを1000Å~2000Åの厚さに真空 蒸着し、大気中45℃で熱処理されたものは1次電 子のエネルギー200eVのとき、2次電子放出係数 は2~2.5であつて、集束電極の貫通孔の有効面 40 積比が1/2のとき貫通孔をそのまま通過する電子 ' ビーム電流の3~4倍の電子ビーム電流を得るこ とができる。

次に本発明の一実施例について述べる。電子ビ

ーム制御電極6a,6bを1㎜ピツチに配列し、

集束電極の孔ピッチを0.1㎞とした。集束電極 1 2 は厚さ30μmのSUS-304であつて、孔形状は 電子ビームの入射側70μm径、出口側30μm径の 5 錐体状とした。電極表面にAIを約1000 A 蒸着 し、大気中で450℃に加熱し、表面にAl₂O₃膜を

6

形成した。

また、制御電極4と前記集束電極の間に1㎜ピ ツチの偏向電極板を配置した。制御電極に設けた 10 孔径は0.4㎜である。前記偏向電極板板および前 記集束電極板に適当の電圧を印加すると集束電極 板上に直径0.2㎜の電子ビームスポツト(ビーム 径は制御電極、偏向電極、集束電極に印加する電 圧および各電極間距離によつて決まる)を得た。 15 ビーム電流 I は入射ビーム電流を I oとするとき 次式で表わされる。

$$I = \frac{(r_1^2 - r_0^2) \times \gamma + r_0^2}{r^2} I_0$$

ここで、rは錐体形状でない従来の孔の直径、 20 riは電子ビームの入射側の孔径 roは出口側の孔 径、γは2次電子放出係数である。錐体形状でな い従来の孔径を50μm、γ=2とすると、I= 3.56%となり3.56倍に増加することがわかる。実 験結果は約3倍であつた。前述の如く、電子ビー 射電子エネルギー200eVにおいて2次電子放出係 25 ム制御電極と集束電極とは孔ピツチおよび位置関 係、任意に設定されており、電子ビームの偏向に よつて、ビームの集束電極板上での位置は任意の 位置であつてもよい。

なお、電子ビームの衝突によつて発光せしめら よる表面処理が施されたものは、製造上やや困難 30 れる螢光体 10の発光に寄与する面積は、集束電 極が設けられることによつて小さくなるが、制御 電極板4と集束電極12との間に偏向電極を設け ると、電子ビームは偏向されるので、電子ビーム が衝突する螢光体10の発光に寄与する面積が大 前述のとおり集束電極12の貫通孔13のピツチ は制御電極板4の貫通孔6 bのピッチより小さい ので、制御電極板4と集束電極12の間での偏向 が上述のとおり有効に作用するものである。

> 以上の説明から明らかなように本発明の画像表 示装置は集束電極に設けられた貫通孔が電子ビー ム入射側に広い錘体状であるので電子ピームの衝 突による2次電子放出量が大きく、電子ビーム電 流が大きくなり、高輝度の画像が得られる。

7

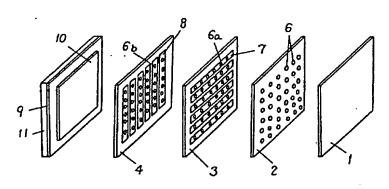
図面の簡単な説明

第1図は従来の画像表示装置の構成図、第2図 は本発明の一実施例を示す画像表示装置の構成 図、第3図は同画像表示装置の要部断面図であ る。

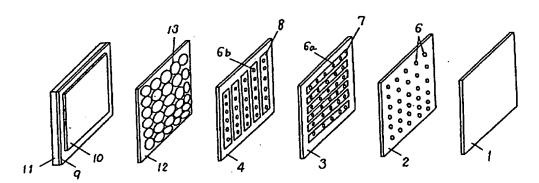
1 ······電子源、2 ·····格子状電極板、3, 4 ··· ···制御電極板、12 ······集束電極、13 ······資通 孔、14 ·····・電子ビーム。

8

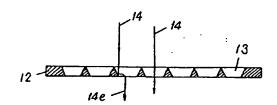
第1図



第2図



第3図



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-326306

(43)公開日 平成7年(1995)12月12日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H01J 29/8	6 Z			
31/1	2 B			
31/1	5 Z	a		

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 6 頁)

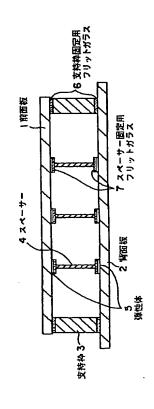
(21)出願番号	特願平6-119857	(71)出願人	
			キヤノン株式会社
(22)出願日	平成6年(1994)6月1日		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	東 尚史
		,	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(72)発明者	多川 昌宏
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(74)代理人	弁理士 若林 忠
	·		

(54) 【発明の名称】 画像形成装置

(57)【要約】

【目的】 画像形成装置の破損防止、すなわち安全性と 歩留りの向上を図る。

【構成】 前面板1と背面板2の間には、弾性体5の位置でスペーサー固定用フリットガラス7を介して大気圧支持部材としてのスペーサー4が配設され、かつ、背面板2および前面板1の周縁にて支持枠固定用フリットガラス6を介して支持枠3が配設されている。



【特許請求の範囲】

電子放出素子群を搭載した背面板と、該 【請求項1】 背面板と対向して配置されると共に前記電子放出素子群 から放出される電子線の照射により画像が形成される画 像形成部材を搭載した前面板と、前記前面板と前記背面 板の間に配置されたスペーサーとを少なくとも有し、前 記前面板、前記背面板をフリットガラスにより互いに接 合して気密構造にされた画像形成装置において、

前記スペーサーと前記前面板、および前記スペーサと前 記背面板の間に弾性体が配置されていることを特徴とす 10 る画像形成装置。

【請求項2】 前記弾性体としては、前記スペーサーの ヤング率よりも低ヤング率のものを用いることを特徴と する、請求項1に記載の画像形成装置。

前記気密接合した容器内が真空であるこ 【請求項3】 とを特徴とする、請求項1または2に記載の画像形成装 置。

前記スペーサーを前記前面板と前記背面 【請求項4】 板の大気圧支持部材として用いることを特徴とする、請 求項1または2に記載の画像形成装置。

前記スペーサーを前記前面板と前記背面 【請求項5】 板の間隔設定部材として用いることを特徴とする、請求 項1または2に記載の画像形成装置。

【請求項6】 前記電子放出素子として表面伝導型電子 放出素子を用いることを特徴とする、請求項1乃至5の いづれか1項に記載の画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電子源を応用して画像 を形成する薄型の画像形成装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、電子放出素子として熱電子源と冷 陰極電子源の2種類が知られている。このうち冷陰極電 子源には電界放出型(以下、「FE型」と略す)、金属 /絶縁層/金属型(以下、「MIM型」と略す)や表面 伝導型電子放出素子等がある。FE型の例としては、W. P. Dyke & W. W. Dolan, "Field emission", Advance in Ele ctron Physics, 8, 89 (1956) ℃C. A. Spindt, "Physical pro perties of thin-film field emission cathodes with molybdenum cones", J. Appl. Phys., 47,5248(1976)等が知 られている。

【0003】MIM型の例としては、C.A.Mead, The tu nnel-emission amplifier, J. Appl. Phys., 32, 646 (1961) 等が知られている。

【0004】表面伝導型電子放出素子の例としては、E. 1. Elinson, Radio Eng. Electron Phys., 10, 1290 (1965)等 がある。

[0005] 表面伝導型電子放出素子は基板上に形成さ れた小面積の薄膜に、膜面に平行に電流を流すことによ り、電子放出が生じる現象を利用するものである。

【0006】このSCEとしては、前記エリンソン等に よるSnO, 薄膜を用いたもの、Au 薄膜によるもの [G. Dittmer: Thin Solid Films, 9, 317, (1972)], I n,O,/SnO,薄膜によるもの [M. Hartwell and C.G. Fonstad: IEEE Trans. ED Conf. 7,519, (1975)]、カー ボン薄膜によるもの [荒木 久:"真空", 第26巻, 第1号、22頁(1983年)]等が報告されている。 【0007】上述したような電子放出素子は10⁻⁶To r r 程度以上の真空中で動作させていることから、前記 電子放出素子を用いて画像形成装置を形成する場合、耐 大気圧構造が必要になる。特に大面積の背面板および前 面板を用いて大気圧支持を行う平面型画像形成装置の場 合、各板厚が非常に厚くなってしまうので、重量、コス トなどの面で実現性が乏しくなる。この問題を回避する ために、スペーサーを前面板と背面板との間に配置し て、大気圧支持部材とすることで、画像形成装置の軽量 化を図っている。

【0008】従来、前面板とスペーサー、および背面板 とスペーサーは、例えばフリットガラスにて固定され、 前面板と、背面板と、これらの間に配置される支持枠と によって真空容器を形成していた。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前面板 とスペーサー、および背面板とスペーサーを、フリット ガラスで固定し、容器内を真空にすると、スペーサーに 大気圧支持される前面板表面および背面板表面に応力集 中が生じて、そこから前面板および背面板が破損するこ とがあった。

【0010】本発明は、上記従来技術の実情に鑑みてな 30 されたものであって、画像形成装置の破損防止、すなわ ち安全性と歩留りの向上を図った画像形成装置を提供す ることを目的としている。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため の本発明は、電子放出素子群を搭載した背面板と、該背 面板と対向して配置されると共に前記電子放出素子群か ら放出される電子線の照射により画像が形成される画像 形成部材を搭載した前面板と、前記前面板と前記背面板 の間に配置されたスペーサーとを少なくとも有し、前記 前面板、前記背面板をフリットガラスにより互いに接合 して気密構造にされた画像形成装置において、前記スペ ーサーと前記前面板、および前記スペーサと前記背面板 の間に弾性体が配置されていることを特徴とし、前記弾 性体としては、前記スペーサーのヤング率よりも低ヤン グ率のものを用いることを特徴とするものである。

【0012】また、上記画像形成装置において、前記気 密接合した容器内が真空であることを特徴とするもの や、前記スペーサーを前記前面板と前記背面板の大気圧 支持部材として用いることを特徴とするものや、前記ス 50 ペーサーを前記前面板と前記背面板の間隔設定部材とし

40

て用いることを特徴とするものや、前記電子放出素子と して表面伝導型電子放出素子を用いることを特徴とする ものも本発明に属する。

[0013]

【作用】上記のとおりに構成された本発明では、前面 板、背面板およびスペーサー同士を気密接合して容器構 造とした画像形成装置の内部を真空にすると、背面板と 前面板には大気圧が加わり、背面板表面および前面板表 面にスペーサーを支点とする引張応力が作用するが、ス ペーサーと背面板、およびスペーサーと前面板の間に弾 性体を配置することにより、真空排気時に前面板および 背面板が沈み込むため、スペーサー上の前面板表面およ び背面板表面に作用する引張応力値が減少する。

【0014】このため、真空排気時の前面板および背面 板の破損を防止することが可能となり、安全性および歩 留りが向上する。

[0015]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照し て説明する。

【0016】 (第1の実施例) 図1は、本発明の画像形 20 成装置の第1の実施例を示す断面図である。

【0017】本実施例の画像形成装置は、図1に示すよ うに、電子放出素子群(不図示)を搭載した背面板 2 と、背面板2と対向して配置されると共に電子放出素子 群 (不図示) から放出される電子線の照射により画像が 形成される画像形成部材(不図示)を搭載した前面板1 と、背面板2と前面板1の間にあって背面板2および前 ・面板1の周縁を支持する支持枠3と、前面板1と背面板 2の間に支柱として配置されるスペーサー4とを少なく とも備えている。

【0018】ここで、前面板1および背面板2上には、 後述するスペーサーが配置される位置を考慮して、弾性 体5が予め設置されており、前面板1と背面板2の間に は、弾性体5の位置でスペーサー固定用フリットガラス 7を介して大気圧支持部材としてのスペーサー4が配設 され、かつ、背面板2および前面板1の周縁にて支持枠 固定用フリットガラス6を介して支持枠3が配設されて いる。

【0019】そして、前面板1、背面板2、支持枠3お よびスペーサー4同士が接合されることで、本実施例の 画像形成装置は気密容器となっている。

【0020】なお、弾性体5としては、スペーサー4の ヤング率よりも小さいヤング率を有するものを用いてい る。また、スペーサー4の形状、個数、配置などは特に 限定されるものではない。さらに、スペーサー4は、大 気圧支持部材の他に、前面板1と背面板2との間隔設定 部材として用いられる。

【0021】上記のように気密接合した容器内を真空に すると、背面板2と前面板1には大気圧が加わり、背面 る引張応力が作用するが、スペーサー4と背面板2、お よびスペーサー4と前面板1の間に弾性体5を配置する ことによって、真空時に前面板1および背面板2が沈み 込むため、スペーサー4上の前面板1表面および背面板 2表面に作用する引張応力値を減少させることができ

【0022】その際の応力値を図2に示す。この図は、 スペーサー4に大気圧支持される平面板表面に作用する 応力値と気密接合した容器内外の圧力差との関係を示し ている。

【0023】図2に示すとおり、弾性体がある場合には 圧力差が小さい時に応力値が負となる、すなわち圧縮応 力が作用するため、真空排気時の引張応力値を減少させ ることができる。

【0024】次に、本実施例の画像形成装置の製造方法 について説明する。

【0025】本実施例においては、前面板1、背面板 2、支持枠3は青板ガラスを切削加工したものを用い た。また、スペーサー4は青板ガラスを研磨することに より作製した。弾性体5は前記スペーサーのヤング率よ りも低いヤング率のものを使用し、具体的にはAgを主 成分とするペースト状の材料を塗布・焼成し、弾性体と して使用した。また、表面伝導型電子放出素子を背面板 2上に作製した。

【0026】このような前面板1、背面板2、支持枠3 およびスペーサー4を用い、先ず、前面板1上に画像形 成部材(不図示)を搭載し、後工程で前面板1と背面板 2の間に配置されるスペーサー4の位置を考慮して弾性 体5を予め設置した。そして、この前面板1上支持枠固 30 定用フリットガラス6をディスペンサーで塗布し、仮焼 成を行った。その後、支持枠3を前面板2上に位置合わ せした後、本焼成した。

【0027】次に、背面板2上に表面伝導型電子放出素 子(不図示)を形成し、後工程で前面板1と背面板2の 間に配置されるスペーサー4の位置を考慮して弾性体5 を予め設置した。そして、この背面板2上に、支持枠固 定用フリットガラス6をディスペンサーで塗布し、仮焼 成を行った。

【0028】その後、上記の前面板1および背面板2の スペーサー設置位置にスペーサー固定用フリットガラス 7を塗布した後、前面板1上にスペーサー4を搭載し て、焼成、固定した。最後に、上記の前面板1と背面板 2を位置合わせした後に、焼成し、固定した。

【0029】組立工程終了後、上記工程で作製された容 器内を真空状態にするために、支持枠に設けられた排気 管(不図示)を通じて容器内を真空に引き、その後、排 気管を封止した。

【0030】その結果、弾性体5を用いることによっ て、スペーサー4に大気圧支持される前面板1表面およ 板2表面および前面板1表面にスペーサー4を支点とす 50 び背面板2表面に作用する引張り応力値を10%程度減

少させることができ、前面板1および背面板2の破損防 止が可能となった。

【0031】 (第2の実施例) 図3は、本発明の画像形 成装置の第2の実施例を示す断面図である。

【0032】本実施例の画像形成装置は、図3に示すよ うに、電子放出素子群(不図示)を搭載した背面板12 と、背面板12と対向して配置されると共に電子放出素 子群 (不図示) から放出される電子線の照射により画像 が形成される画像形成部材(不図示)を搭載した前面板 11と、背面板12と前面板11の間にあって背面板1 2 および前面板 1 1 の周縁を支持する支持枠 1 3 と、前 面板11と背面板12の間に支柱として配置されるスペ ーサー14とを少なくとも備えている。

【0033】ここで、前面板11および背面板12上に は、後述するスペーサーが配置される位置を考慮して、 弾性体15が予め設置されており、前面板11と背面板 12の間には、弾性体15の位置で大気圧支持部材とし てのスペーサー14が配設され、かつ、背面板2および 前面板1の周縁にて支持枠固定用フリットガラス16を 介して支持枠3が配設されている。

【0034】そして、前面板11、背面板12、支持枠 13およびスペーサー14同士が接合されることで、本 実施例の画像形成装置は気密容器となっている。

[0035]なお、スペーサー4の形状、個数、配置な どは特に限定されるものではない。さらに、スペーサー 4は、大気圧支持部材の他に、前面板1と背面板2との 間隔設定部材として用いられる。

【0036】本実施例においては前面板11、背面板1 2、支持枠13は青板ガラスを切削加工したものを用い ている。また、スペーサー14は青板ガラスを研磨する 30 ことにより作製した。弾性体15としてはスペーサー1 4のヤング率よりも低いヤング率の無機接着剤(本実施 例では東亜合成化学社製アロンセラミック)を用いた。

[0037] そして、第1の実施例と同様の方法により 画像形成装置を作製した。

【0038】組立工程終了後、上記工程で作製された容 器内を真空状態にするために、支持枠に設けられた(図) 示せず)排気管を介して容器内を真空に引き、その後、 排気管を封止した。

って、スペーサー14に大気圧支持される前面板11表 面および背面板12表面に作用する引張応力値を10% 程度減少させることができ、前面板11および背面板1 2の破損防止が可能となった。

【0040】上述した第1および第2の実施例における 電子放出素子としては、従来技術の説明で述べた冷陰極 電子源を用いることができる。冷陰極電子源のうち例と して表面伝導型電子放出素子を挙げてその構成を簡単に 説明する。図4は、表面伝導型電子放出素子の基本的な 構成の一例を示すものであり、(a)はその平面図、

(b) は縦断面図である。

[0041] 表面伝導型電子放出素子は図4に示すよう に、絶縁性基板21を備えており、絶縁性基板21上に は、素子電極25,26が一定間隔L1でそれぞれ配置 されている。この絶縁性基板上21の各素子電極25、 26の間には、薄膜導電体24が形成されている。薄膜 導電体24には、電子を放出する電子放出部23が薄膜 導電体24に通電加熱を施すことにより形成されている (特開平2-56822号公報、特開平4-28139 号公報参照)。

【0042】電子放出部23としては粒径が数十オング ストローム程度の導電性微粒子からなり、電子放出部2 3以外の薄膜24は微粒子膜からなる。

【0043】なおここで述べる微粒子膜とは、複数の微 粒子が集合した膜であり、その微細構造として、微粒子 が個々に分散配置した状態のみならず、微粒子が互いに 隣接、あるいは重なり合った状態(島状も含む)の膜を

【0044】またこれとは別に薄膜24には、導電性微 20 粒子が分散されたカーポン薄膜等の場合がある。

【0045】薄膜導電体24の具体例を挙げるならば、 Pb, Ru, Ag, Ti, In, Cu, Cr, Fe, Z n、Sn、Ta、W、Pbなどの金属、PbO、SnO ,、In,O,、PbO、Sb,O,などの酸化物、HfB 2、ZrB2、LaB6、CeB6、YB4、GdB4などの 硼化物、TiC、ZrC、HfC、TaC、SiC、W Cなどの炭化物、TiN、ZrN、HfNなどの窒化 物、Si、Geなどの半導体、カーボン、AgMg、N i Cuなどである。

【0046】そして、薄膜導電体24は、真空蒸着法、 スパッタ法、化学的気相堆積法、分散塗布法、ディッピ ング法、スピナー法などによって形成される。

【0047】この表面伝導型電子放出素子の製造方法の 一例について説明すると、図4において、まず、絶縁性 基板21として青板ガラスを用い、絶縁性基板21上に Niを用いて素子電極25,26を形成した。この時、 素子電極間隔L 1 を 3 μm、素子電極幅W 1 を 5 0 0 μ m、素子電極の厚さdを1000Åとした。

【0048】次に、素子電極上を含む所望の位置に有機 [0039] その結果、弾性体15を設置することによ 40 パラジウム (ccp-4230:奥野製薬株式会社製) 含有溶液を塗布した後、300℃で10分間の加熱処理 をして、酸化パラジウム(PdO)微粒子(平均粒径: 70人) からなる薄膜導電体24を形成した。この時、 薄膜導電体24の幅W2は300μmとした。

> [0049] なお本発明は、このような表面伝導型電子 放出素子に限られず、従来技術の説明で述べたようなF E型、MIM型等を用いても良い。

[0050]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、スペーサ 50 - と背面板、およびスペーサーと前面板の間に弾性体を

7

配置した構成であるので、スペーサー上の前面板表面および背面板表面に作用する引張応力値を減少させ、前面板および背面板の破損を防止することができる。

【0051】したがって、画像形成装置の安全性が増す と共に、歩留りが向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の画像形成装置の第1の実施例を示す断面図である。

【図2】スペーサーに大気圧支持される平面板表面に作用する応力値と気密接合した容器内外の圧力差との関係 10 を示した図である。

【図3】本発明の画像形成装置の第2の実施例を示す断面図である。

【図4】表面伝導型電子放出素子の基本的な構成の一例

を示すものであり、(a) はその平面図、(b) は縦断面図である。

【符号の説明】

1, 11 前面板

2,12 背面板

3, 13 支持枠

4、14 スペーサー

5, 15 弹性体

6.16 支持枠固定用フリットガラス

7 スペーサー固定用フリットガラス

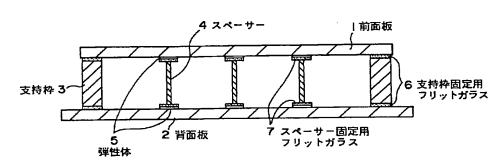
21 絶縁性基板

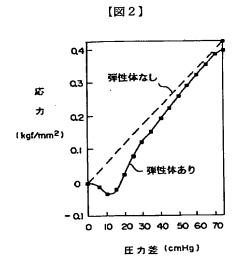
23 電子放出部

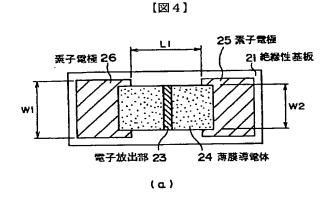
24 薄膜導電体

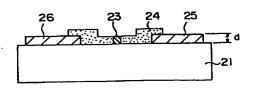
25, 26 素子電極

[図1]









【図3】

